



バウンダリスキャン研究会 2022年度公開研究会

主催:バウンダリスキャン研究会

◆公開研究会のご案内

バウンダリスキャン研究会は、日本でのバウンダリスキャンの普及を目指して活動しています。バウンダリスキャンは高密度実装電子回路におけるICチップ間相互接続を保証する試験技術です。今回の公開研究会では、先端実装技術とそれを支える技術として、チップレットなど最先端実装技術動向、フライングプローブテスト技術と日本のものづくりの課題、サイバーフィジカルシステムのセキュリティについて各界の専門家をお招きして講演して頂きます。

開催日時 2022年9月14日(水) 13:30~16:50

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:30~13:40

オープニング

司会 バウンダリスキャン研究会 主査 亀山 修一(愛媛大学)

13:40~14:40

<招待講演>

「チップレット実装およびウェハ実装による3次元集積実装技術の最新動向」

産業技術総合研究所 菊地 克弥 氏

<概要>

AI・IoT社会のさらなる発展に向けて、車載半導体やビッグデータ処理などへの応用を想定し、チップレット実装によるシリコン貫通電極(TSV)や裏面埋設配線(BBM)の製造技術、ウェハ実装によるハイブリッド接合技術を含めた3次元集積実装技術の研究開発の最新の技術動向について紹介する。

(休憩10分)

14:50~15:35

「フライングプローブテストビジネスから見えてきた日本のものづくりの課題」

タカヤ株式会社 柳田 幸輝 氏

<概要>

タカヤ株式会社は1987年に世界初のフライングプローブテスターをリリース後、30年以上にわたって世界トップシェアの座を守り続けています。本講演ではフライングプローブテストの最先端技術の紹介と、同社が世界のものづくりと関わってきた経験から見えてきた日本のものづくりの課題について語って頂きます。

15:35~16:20

「サイバーフィジカルシステムにおけるセキュリティ脅威と対策について」
愛媛大学 王 森レイ 氏

<概要>

IoTの普及に伴い、フィジカルとサイバー空間の境界にあるエッジデバイスがサイバー攻撃の標的になることが懸念されている。本講演では、サイバー・フィジカルシステムにおける攻撃の脅威と、その対策のための軽量なエッジ認証技術として取り組んでいるJTAG認証機構を紹介する。

16:20~16:40

総合質疑応答

16:40~16:50

エンディング（最後まで聴講された方には有益なお知らせがあります）

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:2,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:2,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:2,000円 非会員学生:2,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されると、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。

*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info@jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)